

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
【部門区分】第 7 部門第 2 区分  
【発行日】令和 7 年 7 月 9 日(2025.7.9)

【公開番号】特開 2023-107724(P2023-107724A)  
【公開日】令和 5 年 8 月 3 日(2023.8.3)  
【年通号数】公開公報(特許)2023-145  
【出願番号】特願 2022-143297(P2022-143297)  
【国際特許分類】

H 0 1 G 4/30(2006.01)

10

【F I】

H 0 1 G 4/30 2 0 1 M

H 0 1 G 4/30 2 0 1 L

H 0 1 G 4/30 2 0 1 F

H 0 1 G 4/30 2 0 1 G

H 0 1 G 4/30 2 0 1 Z

H 0 1 G 4/30 2 0 1 K

H 0 1 G 4/30 2 0 1 C

H 0 1 G 4/30 5 1 2

H 0 1 G 4/30 5 1 3

H 0 1 G 4/30 5 1 5

H 0 1 G 4/30 5 1 6

20

【手続補正書】

【提出日】令和 7 年 7 月 1 日(2025.7.1)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

30

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

誘電体層、及び前記誘電体層を挟んで交互に配置される第 1 内部電極及び第 2 内部電極を含み、第 1 方向に対向する第 1 面及び第 2 面、前記第 1 面及び前記第 2 面と連結され、第 2 方向に対向する第 3 面及び第 4 面、前記第 1 面から前記第 4 面と連結され、第 3 方向に対向する第 5 面及び第 6 面を含む本体と、

前記第 3 面に配置される第 1 接続部、前記第 1 接続部から前記第 1 面の一部まで延びる第 1 バンド部を含む第 1 外部電極と、

前記第 4 面に配置される第 2 接続部、前記第 2 接続部から前記第 1 面の一部まで延びる第 2 バンド部を含む第 2 外部電極と、

40

前記第 2 面上に配置されて、前記第 1 接続部及び第 2 接続部上に延びて配置される絶縁層と、

前記第 1 バンド部上に配置される第 1 めっき層と、

前記第 2 バンド部上に配置される第 2 めっき層と、を含み、

前記絶縁層はガラスを含み、前記絶縁層のうち前記第 2 面上に配置された領域は、前記第 1 方向に凸状を有する、積層型電子部品。

【請求項 2】

前記絶縁層のうち前記第 2 面上に配置された領域は、前記第 2 方向の中央における前記第 1 方向の太さが、前記第 2 方向の端部における前記第 1 方向の太さよりも大きい、請求項 1 に記載の積層型電子部品。

50

## 【請求項 3】

前記絶縁層のうち前記第 2 面上に配置された領域は、前記第 3 方向の中央における前記第 1 方向の大きさが、前記第 3 方向の端部における前記第 1 方向の大きさよりも大きい、請求項 2 に記載の積層型電子部品。

## 【請求項 4】

前記第 1 内部電極は前記第 3 面と連結され、前記第 4 面と離隔して配置され、前記第 2 内部電極は前記第 4 面と連結され、前記第 3 面と離隔して配置され、

前記第 3 面と前記第 2 内部電極が離隔した領域の前記第 2 方向の平均大きさを  $G_1$ 、前記第 4 面と前記第 1 内部電極が離隔した領域の前記第 2 方向の平均大きさを  $G_2$ 、

前記第 1 面のうち、前記第 3 面の延長線から  $G_1$  の分だけ離隔した地点から前記絶縁層の外表面までの前記第 1 方向の平均大きさを  $L_{1a}$ 、前記第 1 面のうち、前記第 4 面の延長線から  $G_2$  の分だけ離隔した地点から前記絶縁層の外表面までの前記第 1 方向の平均大きさを  $L_{2a}$ 、前記第 1 面の前記第 2 方向の中央から前記絶縁層の外表面までの前記第 1 方向の平均大きさを  $L_c$  とするとき、

$0.4 \leq L_{1a} / L_c \leq 0.8$  及び  $0.4 \leq L_{2a} / L_c \leq 0.8$  を満たす、請求項 1 から 3 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

## 【請求項 5】

前記第 1 面から前記第 1 内部電極及び前記第 2 内部電極のうち、前記第 1 面に最も近く配置された内部電極までの前記第 1 方向の平均大きさを  $H_1$ 、前記第 1 面の延長線から前記第 1 接続部及び前記第 2 接続部に配置されためっき層の端部までの第 1 方向の平均大きさを  $H_2$  とするとき、 $H_1 > H_2$  を満たす、請求項 1 から 3 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

## 【請求項 6】

前記第 1 面から前記第 1 内部電極及び前記第 2 内部電極のうち、前記第 1 面に最も近く配置された内部電極までの前記第 1 方向の平均大きさを  $H_1$ 、前記第 1 面の延長線から前記第 1 接続部及び前記第 2 接続部に配置されためっき層の端部までの前記第 1 方向の平均大きさを  $H_2$  とするとき、 $H_1 < H_2$  を満たす、請求項 1 から 3 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

## 【請求項 7】

前記本体の前記第 1 方向の平均大きさを  $T$  とするとき、 $H_2 < T / 2$  を満たす、請求項 6 に記載の積層型電子部品。

## 【請求項 8】

前記第 1 めっき層及び前記第 2 めっき層は、前記第 1 面の延長線以下に配置される、請求項 1 から 3 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

## 【請求項 9】

前記本体の前記第 2 方向の平均大きさを  $L$ 、前記第 3 面の延長線から前記第 1 バンド部の端部までの前記第 2 方向の平均大きさを  $B_1$ 、前記第 4 面の延長線から前記第 2 バンド部の端部までの前記第 2 方向の平均大きさを  $B_2$  とするとき、

$0.2 \leq B_1 / L \leq 0.4$  及び  $0.2 \leq B_2 / L \leq 0.4$  を満たす、請求項 1 から 3 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

## 【請求項 10】

前記第 1 面上に配置され、前記第 1 バンド部と前記第 2 バンド部との間に配置される追加絶縁層をさらに含む、請求項 1 から 3 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

## 【請求項 11】

前記誘電体層の平均厚さは  $0.35 \mu\text{m}$  以下である、請求項 1 から 3 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

## 【請求項 12】

前記第 1 内部電極及び前記第 2 内部電極の平均厚さは  $0.35 \mu\text{m}$  以下である、請求項 1 から 3 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

## 【請求項 13】

10

20

30

40

50

前記本体は、前記誘電体層を挟んで交互に配置される前記第 1 内部電極及び前記第 2 内部電極を含む容量形成部、及び前記容量形成部の前記第 1 方向の両端面上に配置されるカバ一部を含み、

前記カバ一部の前記第 1 方向の平均大きさは  $1.5 \mu\text{m}$  以下である、請求項 1 から 3 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

【請求項 14】

前記第 1 めっき層及び前記第 2 めっき層の平均厚さは、前記絶縁層のうち前記第 1 接続部及び前記第 2 接続部に配置された領域の平均厚さよりも薄い、請求項 1 から 3 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

【請求項 15】

前記第 1 めっき層は、前記絶縁層の前記第 1 外部電極上に配置された端部を覆うように配置され、前記第 2 めっき層は、前記絶縁層の前記第 2 外部電極上に配置された端部を覆うように配置される、請求項 1 から 3 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

【請求項 16】

前記絶縁層は、前記第 1 めっき層の前記第 1 外部電極上に配置された端部を覆うように配置され、前記絶縁層は、前記第 2 めっき層の前記第 2 外部電極上に配置された端部を覆うように配置される、請求項 1 から 3 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

【請求項 17】

前記第 1 外部電極は、前記第 1 接続部から前記第 5 面及び前記第 6 面の一部まで延びる第 1 側面バンド部を含み、

前記第 2 外部電極は、前記第 2 接続部から前記第 5 面及び前記第 6 面の一部まで延びる第 2 側面バンド部を含み、

前記第 1 側面バンド部及び前記第 2 側面バンド部の前記第 2 方向の大きさは、前記第 1 面に近くなるほど大きくなる、請求項 1 から 3 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

【請求項 18】

前記本体は、前記第 1 面と前記第 3 面を連結する第 1 - 3 コーナー、前記第 1 面と前記第 4 面を連結する第 1 - 4 コーナー、前記第 2 面と前記第 3 面を連結する第 2 - 3 コーナー、前記第 2 面と前記第 4 面を連結する第 2 - 4 コーナーを含み、

前記第 1 - 3 コーナー及び前記第 2 - 3 コーナーは、前記第 3 面に近くなるほど前記本体の前記第 1 方向の中央に収縮した形態を有し、前記第 1 - 4 コーナー及び前記第 2 - 4 コーナーは、前記第 4 面に近くなるほど前記本体の前記第 1 方向の中央に収縮した形態を有し、

前記第 1 外部電極は、前記第 1 接続部において前記第 1 - 3 コーナー及び前記第 2 - 3 コーナー上に延びて配置される第 1 コーナー部を含み、前記第 2 外部電極は、前記第 2 接続部から前記第 1 - 4 コーナー及び前記第 2 - 4 コーナー上に延びて配置される第 2 コーナー部を含む、請求項 1 から 3 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

【請求項 19】

前記第 3 面の延長線から前記第 1 コーナー部の端部までの前記第 2 方向の平均大きさを  $B_3$ 、前記第 4 面の延長線から前記第 2 コーナー部の端部までの前記第 2 方向の平均大きさを  $B_4$ 、前記第 3 面と前記第 2 内部電極が離隔した領域の前記第 2 方向の平均大きさを  $G_1$ 、前記第 4 面と前記第 1 内部電極が離隔した領域の前記第 2 方向の平均大きさを  $G_2$  とするとき、

$B_3 < G_1$  及び  $B_4 < G_2$  を満たす、請求項 18 に記載の積層型電子部品。

【請求項 20】

前記第 1 外部電極は、前記第 3 面上に配置される第 1 連結電極、及び前記第 1 面上に配置されて前記第 1 連結電極と連結される第 1 バンド電極を含み、

前記第 2 外部電極は、前記第 4 面上に配置される第 2 連結電極、及び前記第 1 面上に配置されて前記第 2 連結電極と連結される第 2 バンド電極を含む、請求項 1 から 3 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

【請求項 21】

10

20

30

40

50

前記第 1 外部電極は、前記第 2 面に配置されて、前記第 1 連結電極と連結される第 3 バンド電極をさらに含み、

前記第 2 外部電極は、前記第 2 面に配置されて、前記第 2 連結電極と連結される第 4 バンド電極をさらに含む、請求項 20 に記載の積層型電子部品。

【請求項 22】

前記第 1 外部電極は、前記第 1 接続部から前記第 2 面の一部まで延びる第 3 バンド部を含み、

前記第 2 外部電極は、前記第 2 接続部から前記第 2 面の一部まで延びる第 4 バンド部を含む、請求項 1 から 3 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

【請求項 23】

前記第 1 面のうち前記第 3 面の延長線から G 1 の分だけ離隔した地点から前記絶縁層の外表面までの第 1 方向の平均大きさを L 1 a、前記第 1 面のうち前記第 4 面の延長線から G 2 の分だけ離隔した地点から前記絶縁層の外表面までの第 1 方向の平均大きさを L 2 a

、前記第 1 面の第 2 方向の中央から前記絶縁層の外表面までの第 1 方向の平均大きさを L c、

前記第 3 バンド部の端部から前記絶縁層の外表面までの第 1 方向の平均大きさを L 1 b、前記第 4 バンド部の端部から前記絶縁層の外表面までの第 1 方向の平均大きさを L 2 b とするとき、

$1.1 \times L 1 a - L 1 b - 0.9 \times L c$  及び  $1.1 \times L 2 a - L 2 b - 0.9 \times L c$  を満たす、請求項 22 に記載の積層型電子部品。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0215

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0215】

本発明で使用される用語は、単に一実施形態を説明するために使用されたものであり、本発明を限定する意図ではない。このとき、単数の表現は、文脈上明らかに異なる意味ではない限り、複数の表現を含む。

(項目 1)

誘電体層及び前記誘電体層を間に挟んで交互に配置される第 1 内部電極及び第 2 内部電極を含み、第 1 方向に対向する第 1 面及び第 2 面、前記第 1 面及び前記第 2 面と連結され、第 2 方向に対向する第 3 面及び第 4 面、前記第 1 面から前記第 4 面と連結され、第 3 方向に対向する第 5 面及び第 6 面を含む本体と、

前記第 3 面に配置される第 1 接続部、前記第 1 接続部から前記第 1 面の一部まで延長される第 1 バンド部、前記第 1 接続部から前記第 2 面の一部まで延長される第 3 バンド部を含む第 1 外部電極と、

前記第 4 面に配置される第 2 接続部、前記第 2 接続部から前記第 1 面の一部まで延長される第 2 バンド部、及び前記第 2 接続部から前記第 2 面の一部まで延長される第 4 バンド部を含む第 2 外部電極と、

前記第 2 面上に配置され、前記第 1 接続部及び前記第 2 接続部上に延長して配置される絶縁層と、

前記第 1 バンド部上に配置される第 1 めっき層と、

前記第 2 バンド部上に配置される第 2 めっき層と、を含み、

前記絶縁層はガラスを含み、前記絶縁層のうち前記第 2 面上に配置された領域は前記第 1 方向に凸形状を有する、積層型電子部品。

(項目 2)

前記絶縁層のうち前記第 2 面上に配置された領域は、前記第 2 方向の中央における前記第 1 方向のサイズが前記第 2 方向の端部における前記第 1 方向のサイズより大きい、項目

10

20

30

40

50

1 に記載の積層型電子部品。

(項目 3)

前記絶縁層のうち前記第 2 面上に配置された領域は、前記第 3 方向の中央における前記第 1 方向のサイズが前記第 3 方向の端部における前記第 1 方向のサイズより大きい、項目 2 に記載の積層型電子部品。

(項目 4)

前記第 1 内部電極は前記第 3 面と連結され、前記第 4 面と離隔して配置され、前記第 2 内部電極は前記第 4 面と連結され、前記第 3 面と離隔して配置され、

前記第 3 面と前記第 2 内部電極が離隔した領域の前記第 2 方向の平均サイズを  $G_1$ 、前記第 4 面と前記第 1 内部電極が離隔した領域の前記第 2 方向の平均サイズを  $G_2$ 、

前記第 1 面のうち前記第 3 面の延長線から  $G_1$  だけ離隔した地点から前記絶縁層の外表面までの前記第 1 方向の平均サイズを  $L_{1a}$ 、前記第 1 面のうち前記第 4 面の延長線から  $G_2$  だけ離隔した地点から前記絶縁層の外表面までの前記第 1 方向の平均サイズを  $L_{2a}$ 、前記第 1 面の前記第 2 方向の中央から前記絶縁層の外表面までの前記第 1 方向の平均サイズを  $L_c$  とするとき、

$0.4 \leq L_{1a} / L_c \leq 0.8$  及び  $0.4 \leq L_{2a} / L_c \leq 0.8$  を満たす、項目 1 から 3 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 5)

前記第 3 面の延長線から前記第 3 バンド部の端までの前記第 2 方向の平均サイズを  $B_3$ 、前記第 4 面の延長線から前記第 4 バンド部の端までの前記第 2 方向の平均サイズを  $B_4$  とするとき、

$B_1 \leq G_1$  及び  $B_2 \leq G_2$  を満たす、項目 4 に記載の積層型電子部品。

(項目 6)

前記第 3 バンド部の端から前記絶縁層の外表面までの前記第 1 方向の平均サイズを  $L_{1b}$ 、

前記第 4 バンド部の端から前記絶縁層の外表面までの前記第 1 方向の平均サイズを  $L_{2b}$  とするとき、

$1.1 \times L_{1a} \leq L_{1b} \leq 0.9 \times L_c$  及び  $1.1 \times L_{2a} \leq L_{2b} \leq 0.9 \times L_c$  を満たす、項目 5 に記載の積層型電子部品。

(項目 7)

前記第 3 面の延長線から前記第 1 バンド部の端までの前記第 2 方向の平均サイズを  $B_1$ 、前記第 4 面の延長線から前記第 2 バンド部の端までの前記第 2 方向の平均サイズを  $B_2$  とするとき、

$B_1 \leq G_1$  及び  $B_2 \leq G_2$  を満たす、項目 5 に記載の積層型電子部品。

(項目 8)

前記第 1 面から前記第 1 内部電極及び前記第 2 内部電極のうち前記第 1 面に最も近く配置された内部電極までの前記第 1 方向の平均サイズを  $H_1$ 、前記第 1 面の延長線から前記第 1 接続部及び前記第 2 接続部上に配置されためっき層の端までの前記第 1 方向の平均サイズを  $H_2$  とするとき、 $H_1 \leq H_2$  を満たす、項目 1 から 3 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 9)

前記第 1 面から前記第 1 内部電極及び前記第 2 内部電極のうち前記第 1 面に最も近く配置された内部電極までの前記第 1 方向の平均サイズを  $H_1$ 、前記第 1 面の延長線から前記第 1 接続部及び前記第 2 接続部上に配置されためっき層の端までの前記第 1 方向の平均サイズを  $H_2$  とするとき、 $H_1 < H_2$  を満たす、項目 1 から 3 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 10)

前記本体の第 1 方向の平均サイズを  $T$  とするとき、

$H_2 < T / 2$  を満たす、項目 9 に記載の積層型電子部品。

(項目 11)

10

20

30

40

50

前記第 1 めっき層及び前記第 2 めっき層は、前記第 1 面の延長線未滿に配置される、項目 1 から 3 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 1 2)

前記本体の第 2 方向の平均サイズを  $L$ 、前記第 3 面の延長線から前記第 1 バンド部の端までの前記第 2 方向の平均サイズを  $B_1$ 、前記第 4 面の延長線から前記第 2 バンド部の端までの前記第 2 方向の平均サイズを  $B_2$  とするとき、

$0.2 \leq B_1 / L \leq 0.4$  及び  $0.2 \leq B_2 / L \leq 0.4$  を満たす、項目 1 から 3 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 1 3)

前記第 1 面上に配置され、前記第 1 バンド部と前記第 2 バンド部との間に配置される追加絶縁層をさらに含む、項目 1 から 3 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 1 4)

前記第 1 外部電極及び前記第 2 外部電極は、Ni 及び Ni 合金のうち一つ以上を含む、項目 1 から 3 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 1 5)

前記第 3 面の延長線から前記第 1 バンド部の端までの前記第 2 方向の平均サイズを  $B_1$ 、前記第 4 面の延長線から前記第 2 バンド部の端までの前記第 2 方向の平均サイズを  $B_2$ 、前記第 3 面の延長線から前記第 3 バンド部の端までの前記第 2 方向の平均サイズを  $B_3$ 、前記第 4 面の延長線から前記第 4 バンド部の端までの前記第 2 方向の平均サイズを  $B_4$  とするとき、

$B_3 < B_1$  及び  $B_4 < B_2$  を満たす、項目 1 から 3 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 1 6)

前記積層型電子部品の前記第 2 方向の最大サイズは  $1.1 \text{ mm}$  以下であり、前記第 3 方向の最大サイズは  $0.55 \text{ mm}$  以下である、項目 1 から 3 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 1 7)

前記誘電体層の平均厚さは  $0.35 \mu\text{m}$  以下である、項目 1 から 3 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 1 8)

前記第 1 内部電極及び前記第 2 内部電極の平均厚さは  $0.35 \mu\text{m}$  以下である、項目 1 から 3 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 1 9)

前記本体は、前記誘電体層を間に挟んで交互に配置される前記第 1 内部電極及び前記第 2 内部電極を含む容量形成部、及び前記容量形成部の前記第 1 方向の両端面上に配置されるカバー部を含み、

前記カバー部の前記第 1 方向の平均サイズは  $15 \mu\text{m}$  以下である、項目 1 から 3 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 2 0)

前記第 1 めっき層及び前記第 2 めっき層の平均厚さは、前記絶縁層のうち前記第 1 接続部及び前記第 2 接続部上に配置された領域の平均厚さより薄い、項目 1 から 3 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 2 1)

前記第 1 めっき層は、前記絶縁層の前記第 1 外部電極上に配置された端を覆うように配置され、前記第 2 めっき層は、前記絶縁層の前記第 2 外部電極上に配置された端を覆うように配置される、項目 1 から 3 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 2 2)

前記絶縁層は、前記第 1 めっき層の前記第 1 外部電極上に配置された端を覆うように配置され、前記絶縁層は、前記第 2 めっき層の前記第 2 外部電極上に配置された端を覆うように配置される、項目 1 から 3 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

10

20

30

40

50

( 項目 2 3 )

前記第 1 外部電極は、前記第 1 接続部から前記第 5 面及び前記第 6 面の一部まで延長される第 1 側面バンド部を含み、

前記第 2 外部電極は、前記第 2 接続部から前記第 5 面及び前記第 6 面の一部まで延長される第 2 側面バンド部を含み、

前記第 1 側面バンド部及び前記第 2 側面バンド部の前記第 2 方向のサイズは、前記第 1 面に近づくほど大きくなる、項目 1 から 3 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

( 項目 2 4 )

前記第 1 外部電極は、前記第 1 接続部から前記第 5 面及び前記第 6 面の一部まで延長される第 1 側面バンド部を含み、

前記第 2 外部電極は、前記第 2 接続部から前記第 5 面及び前記第 6 面の一部まで延長される第 2 側面バンド部を含み、

前記絶縁層は、前記第 1 側面バンド部及び第 2 側面バンド部、前記第 5 面及び前記第 6 面の一部を覆うように配置される、項目 1 から 3 のいずれか一項に記載の積層型電子部品  
—

( 項目 2 5 )

前記第 1 外部電極は、前記第 1 接続部から前記第 5 面及び前記第 6 面の一部まで延長される第 1 側面バンド部を含み、

前記第 2 外部電極は、前記第 2 接続部から前記第 5 面及び前記第 6 面の一部まで延長される第 2 側面バンド部を含み、

前記絶縁層は、前記第 1 側面バンド部、前記第 2 側面バンド部、前記第 5 面及び前記第 6 面を全て覆うように配置される、項目 1 から 3 のいずれか一項に記載の積層型電子部品  
—

( 項目 2 6 )

前記本体は、前記第 1 面と前記第 3 面を連結する第 1 - 3 コーナー、前記第 1 面と前記第 4 面を連結する第 1 - 4 コーナー、前記第 2 面と前記第 3 面を連結する第 2 - 3 コーナー、前記第 2 面と前記第 4 面を連結する第 2 - 4 コーナーを含み、

前記第 1 - 3 コーナー及び前記第 2 - 3 コーナーは、前記第 3 面に近づくほど、前記本体の前記第 1 方向の中央に収縮した形態を有し、前記第 1 - 4 コーナー及び前記第 2 - 4 コーナーは、前記第 4 面に近づくほど、前記本体の前記第 1 方向の中央に収縮した形態を有し、

前記第 1 外部電極は、前記第 1 接続部から前記第 1 - 3 コーナー及び前記第 2 - 3 コーナー上に延長して配置されるコーナー部を含み、前記第 2 外部電極は、前記第 2 接続部から前記第 1 - 4 コーナー及び前記第 2 - 4 コーナー上に延長して配置されるコーナー部を含む、項目 1 から 3 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

( 項目 2 7 )

誘電体層及び前記誘電体層を間に挟んで交互に配置される第 1 内部電極及び第 2 内部電極を含み、第 1 方向に対向する第 1 面及び第 2 面、前記第 1 面及び前記第 2 面と連結され、第 2 方向に対向する第 3 面及び第 4 面、前記第 1 面から前記第 4 面と連結され、第 3 方向に対向する第 5 面及び第 6 面を含む本体と、

前記第 3 面に配置される第 1 接続部、前記第 1 接続部から前記第 1 面の一部まで延長される第 1 バンド部を含む第 1 外部電極と、

前記第 4 面に配置される第 2 接続部、前記第 2 接続部から前記第 1 面の一部まで延長される第 2 バンド部を含む第 2 外部電極と、

前記第 2 面上に配置され、前記第 1 接続部及び前記第 2 接続部上に延長して配置される絶縁層と、

前記第 1 バンド部上に配置される第 1 めっき層と、

前記第 2 バンド部上に配置される第 2 めっき層と、を含み、

前記絶縁層はガラスを含み、前記絶縁層のうち第 2 面上に配置された領域は前記第 1 方向に凸形状を有する、積層型電子部品。

10

20

30

40

50

( 項目 2 8 )

前記絶縁層のうち前記第 2 面上に配置された領域は、前記第 2 方向の中央における前記第 1 方向のサイズが前記第 2 方向の端部における前記第 1 方向のサイズより大きい、項目 2 7 に記載の積層型電子部品。

( 項目 2 9 )

前記絶縁層のうち前記第 2 面上に配置された領域は、前記第 3 方向の中央における前記第 1 方向のサイズが前記第 3 方向の端部における前記第 1 方向のサイズより大きい、項目 2 8 に記載の積層型電子部品。

( 項目 3 0 )

前記第 1 内部電極は前記第 3 面と連結され、前記第 4 面と離隔して配置され、前記第 2 内部電極は前記第 4 面と連結され、前記第 3 面と離隔して配置され、

前記第 3 面と前記第 2 内部電極が離隔した領域の前記第 2 方向の平均サイズを  $G_1$ 、前記第 4 面と前記第 1 内部電極が離隔した領域の前記第 2 方向の平均サイズを  $G_2$ 、

前記第 1 面のうち前記第 3 面の延長線から  $G_1$  だけ離隔した地点から前記絶縁層の外表面までの前記第 1 方向の平均サイズを  $L_{1a}$ 、前記第 1 面のうち前記第 4 面の延長線から  $G_2$  だけ離隔した地点から前記絶縁層の外表面までの前記第 1 方向の平均サイズを  $L_{2a}$ 、前記第 1 面の前記第 2 方向の中央から前記絶縁層の外表面までの前記第 1 方向の平均サイズを  $L_c$  とするとき、

$0.4 \leq L_{1a} / L_c \leq 0.8$  及び  $0.4 \leq L_{2a} / L_c \leq 0.8$  を満たす、項目 2 7 から 2 9 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

( 項目 3 1 )

前記第 1 面から前記第 1 内部電極及び前記第 2 内部電極のうち前記第 1 面に最も近く配置された内部電極までの前記第 1 方向の平均サイズを  $H_1$ 、前記第 1 面の延長線から前記第 1 接続部及び前記第 2 接続部上に配置されためっき層の端までの前記第 1 方向の平均サイズを  $H_2$  とするとき、 $H_1 \leq H_2$  を満たす、項目 2 7 から 2 9 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

( 項目 3 2 )

前記第 1 面から前記第 1 内部電極及び前記第 2 内部電極のうち前記第 1 面に最も近く配置された内部電極までの前記第 1 方向の平均サイズを  $H_1$ 、前記第 1 面の延長線から前記第 1 接続部及び前記第 2 接続部上に配置されためっき層の端までの前記第 1 方向の平均サイズを  $H_2$  とするとき、 $H_1 < H_2$  を満たす、項目 2 7 から 2 9 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

( 項目 3 3 )

前記本体の第 1 方向の平均サイズを  $T$  とするとき、

$H_2 < T / 2$  を満たす、項目 3 2 に記載の積層型電子部品。

( 項目 3 4 )

前記第 1 めっき層及び前記第 2 めっき層は、前記第 1 面の延長線未滿に配置される、項目 2 7 から 2 9 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

( 項目 3 5 )

前記本体の前記第 2 方向の平均サイズを  $L$ 、前記第 3 面の延長線から前記第 1 バンド部の端までの前記第 2 方向の平均サイズを  $B_1$ 、前記第 4 面の延長線から前記第 2 バンド部の端までの前記第 2 方向の平均サイズを  $B_2$  とするとき、

$0.2 \leq B_1 / L \leq 0.4$  及び  $0.2 \leq B_2 / L \leq 0.4$  を満たす、項目 2 7 から 2 9 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

( 項目 3 6 )

前記第 1 面上に配置され、前記第 1 バンド部と前記第 2 バンド部との間に配置される追加絶縁層をさらに含む、項目 2 7 から 2 9 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

( 項目 3 7 )

前記第 1 外部電極及び前記第 2 外部電極は、 $Ni$  及び  $Ni$  合金のうち一つ以上を含む、項目 2 7 から 2 9 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。



(項目 3 8)

前記積層型電子部品の前記第 2 方向の最大サイズは 1 . 1 mm 以下であり、前記第 3 方向の最大サイズは 0 . 5 5 mm 以下である、項目 2 7 から 2 9 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 3 9)

前記誘電体層の平均厚さは 0 . 3 5  $\mu$ m 以下である、項目 2 7 から 2 9 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 4 0)

前記第 1 内部電極及び前記第 2 内部電極の平均厚さは 0 . 3 5  $\mu$ m 以下である、項目 2 7 から 2 9 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

10

(項目 4 1)

前記誘電体層を間に挟んで交互に配置される前記第 1 内部電極及び前記第 2 内部電極を含む容量形成部、及び前記容量形成部の前記第 1 方向の両端面上に配置されるカバー部を含み、

前記カバー部の前記第 1 方向の平均サイズは 1 5  $\mu$ m 以下である、項目 2 7 から 2 9 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 4 2)

前記第 1 めっき層及び前記第 2 めっき層の平均厚さは、前記絶縁層のうち前記第 1 接続部及び前記第 2 接続部に配置された領域の平均厚さより薄い、項目 2 7 から 2 9 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

20

(項目 4 3)

前記第 1 接続部及び前記第 2 接続部は、前記第 5 面及び前記第 6 面と離隔して配置される、項目 2 7 から 2 9 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 4 4)

前記第 1 接続部及び前記第 2 接続部は、前記第 2 面と離隔して配置される、項目 2 7 から 2 9 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 4 5)

前記第 1 めっき層は、前記絶縁層の前記第 1 外部電極上に配置された端を覆うように配置され、前記第 2 めっき層は、前記絶縁層の前記第 2 外部電極上に配置された端を覆うように配置される、項目 2 7 から 2 9 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

30

(項目 4 6)

前記絶縁層は、前記第 1 めっき層の前記第 1 外部電極上に配置された端を覆うように配置され、前記絶縁層は、前記第 2 めっき層の前記第 2 外部電極上に配置された端を覆うように配置される、項目 2 7 から 2 9 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 4 7)

前記絶縁層は、前記第 5 面及び前記第 6 面の一部を覆うように配置される、項目 2 7 から 2 9 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 4 8)

前記絶縁層は、前記第 5 面及び前記第 6 面の全部を覆うように配置される、項目 2 7 から 2 9 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

40

(項目 4 9)

前記本体は、前記第 1 面と前記第 3 面を連結する第 1 - 3 コーナー、前記第 1 面と前記第 4 面を連結する第 1 - 4 コーナー、前記第 2 面と前記第 3 面を連結する第 2 - 3 コーナー、前記第 2 面と前記第 4 面を連結する第 2 - 4 コーナーを含み、

前記第 1 - 3 コーナー及び前記第 2 - 3 コーナーは、前記第 3 面に近づくほど、前記本体の前記第 1 方向の中央に収縮した形態を有し、前記第 1 - 4 コーナー及び前記第 2 - 4 コーナーは、前記第 4 面に近づくほど、前記本体の前記第 1 方向の中央に収縮した形態を有し、

前記第 1 外部電極は、前記第 1 - 3 コーナー上に配置されるコーナー部及び前記第 1 接続部から前記第 2 - 3 コーナー上に延長して配置されるコーナー部を含み、前記第 2 外部

50

電極は、前記第 1 - 4 コーナー上に配置されるコーナー部及び前記第 2 接続部から前記第 2 - 4 コーナー上に延長して配置されるコーナー部を含む、項目 27 から 29 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 50)

誘電体層及び前記誘電体層を間に挟んで交互に配置される第 1 内部電極及び第 2 内部電極を含み、第 1 方向に対向する第 1 面及び第 2 面、前記第 1 面及び前記第 2 面と連結され、第 2 方向に対向する第 3 面及び第 4 面、前記第 1 面から前記第 4 面と連結され、第 3 方向に対向する第 5 面及び第 6 面を含む本体と、

前記第 3 面に配置される第 1 接続部、前記第 1 接続部から前記第 1 面の一部まで延長される第 1 バンド部、前記第 1 接続部から前記第 2 面と前記第 3 面を連結するコーナーに延長して配置される第 1 コーナー部を含む第 1 外部電極と、

前記第 4 面に配置される第 2 接続部、前記第 2 接続部から前記第 1 面の一部まで延長される第 2 バンド部、及び前記第 2 接続部から前記第 2 面と前記第 4 面を連結するコーナーに延長して配置される第 2 コーナー部を含む第 2 外部電極と、

前記第 1 接続部及び前記第 2 接続部上に配置され、前記第 2 面、前記第 1 コーナー部及び第 2 コーナー部を覆うように配置される絶縁層と、

前記第 1 バンド部上に配置される第 1 めっき層と、

前記第 2 バンド部上に配置される第 2 めっき層と、を含み、

前記第 3 面の延長線から前記第 1 コーナー部の端までの前記第 2 方向の平均サイズを B3、前記第 4 面の延長線から前記第 2 コーナー部の端までの前記第 2 方向の平均サイズを B4、前記第 3 面と前記第 2 内部電極が離隔した領域の前記第 2 方向の平均サイズを G1、前記第 4 面と前記第 1 内部電極が離隔した領域の前記第 2 方向の平均サイズを G2 とするとき、

B3 G1 及び B4 G2 を満たし、

前記絶縁層はガラスを含み、前記絶縁層のうち第 2 面上に配置された領域は前記第 1 方向に凸形状を有する、積層型電子部品。

(項目 51)

前記絶縁層のうち前記第 2 面上に配置された領域は、前記第 2 方向の中央における前記第 1 方向のサイズが前記第 2 方向の端部における前記第 1 方向のサイズより大きい、項目 50 に記載の積層型電子部品。

(項目 52)

前記絶縁層のうち前記第 2 面上に配置された領域は、前記第 3 方向の中央における前記第 1 方向のサイズが前記第 3 方向の端部における前記第 1 方向のサイズより大きい、項目 51 に記載の積層型電子部品。

(項目 53)

前記第 1 内部電極は前記第 3 面と連結され、前記第 4 面と離隔して配置され、前記第 2 内部電極は前記第 4 面と連結され、前記第 3 面と離隔して配置され、

前記第 3 面と前記第 2 内部電極が離隔した領域の前記第 2 方向の平均サイズを G1、前記第 4 面と前記第 1 内部電極が離隔した領域の前記第 2 方向の平均サイズを G2、

前記第 1 面のうち前記第 3 面の延長線から G1 だけ離隔した地点から前記絶縁層の外表面までの前記第 1 方向の平均サイズを L1a、前記第 1 面のうち前記第 4 面の延長線から G2 だけ離隔した地点から前記絶縁層の外表面までの前記第 1 方向の平均サイズを L2a、前記第 1 面の前記第 2 方向の中央から前記絶縁層の外表面までの前記第 1 方向の平均サイズを Lc とするとき、

0.4 L1a / Lc 0.8 及び 0.4 L2a / Lc 0.8 を満たす、項目 50 から 52 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 54)

前記第 1 面から前記第 1 内部電極及び前記第 2 内部電極のうち前記第 1 面に最も近く配置された内部電極までの前記第 1 方向の平均サイズを H1、前記第 1 面の延長線から前記第 1 接続部及び前記第 2 接続部上に配置されためっき層の端までの前記第 1 方向の平均サ

10

20

30

40

50

イズを  $H_2$  とするとき、 $H_1 < H_2$  を満たす、項目 50 から 52 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 55)

前記第 1 面から前記第 1 内部電極及び前記第 2 内部電極のうち前記第 1 面に最も近く配置された内部電極までの前記第 1 方向の平均サイズを  $H_1$ 、前記第 1 面の延長線から前記第 1 接続部及び前記第 2 接続部上に配置されためっき層の端までの前記第 1 方向の平均サイズを  $H_2$  とするとき、 $H_1 < H_2$  を満たす、項目 50 から 52 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 56)

前記本体の前記第 1 方向の平均サイズを  $T$  とするとき、

10

$H_2 < T / 2$  を満たす、項目 55 に記載の積層型電子部品。

(項目 57)

前記第 1 めっき層及び前記第 2 めっき層は、前記第 1 面の延長線未滿に配置される、項目 50 から 52 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 58)

前記本体の第 2 方向の平均サイズを  $L$ 、前記第 3 面の延長線から前記第 1 バンド部の端までの前記第 2 方向の平均サイズを  $B_1$ 、前記第 4 面の延長線から前記第 2 バンド部の端までの前記第 2 方向の平均サイズを  $B_2$  とするとき、

$0.2 \leq B_1 / L \leq 0.4$  及び  $0.2 \leq B_2 / L \leq 0.4$  を満たす、項目 50 から 52 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

20

(項目 59)

前記第 1 面上に配置され、前記第 1 バンド部と前記第 2 バンド部との間に配置される追加絶縁層をさらに含む、項目 50 から 52 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 60)

前記第 1 外部電極及び前記第 2 外部電極は、 $Ni$  及び  $Ni$  合金のうち一つ以上を含む、項目 50 から 52 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 61)

前記第 3 面の延長線から前記第 1 バンド部の端までの前記第 2 方向の平均サイズを  $B_1$ 、前記第 4 面の延長線から前記第 2 バンド部の端までの前記第 2 方向の平均サイズを  $B_2$  とするとき、

30

$B_3 < B_1$  及び  $B_4 < B_2$  を満たす、項目 50 から 52 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 62)

前記積層型電子部品の前記第 2 方向の最大サイズは  $1.1 \text{ mm}$  以下であり、前記第 3 方向の最大サイズは  $0.55 \text{ mm}$  以下である、項目 50 から 52 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 63)

前記誘電体層の平均厚さは  $0.35 \text{ }\mu\text{m}$  以下である、項目 50 から 52 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 64)

40

前記第 1 内部電極及び前記第 2 内部電極の平均厚さは  $0.35 \text{ }\mu\text{m}$  以下である、項目 50 から 52 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 65)

前記誘電体層を間に挟んで交互に配置される前記第 1 内部電極及び前記第 2 内部電極を含む容量形成部、及び前記容量形成部の前記第 1 方向の両端面上に配置されるカバー部を含み、

前記カバー部の前記第 1 方向の平均サイズは  $15 \text{ }\mu\text{m}$  以下である、項目 50 から 52 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 66)

前記第 1 めっき層及び前記第 2 めっき層の平均厚さは、前記絶縁層の平均厚さより薄い

50

項目 5 0 から 5 2 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 6 7)

前記第 1 コーナー部及び前記第 2 コーナー部は、前記第 2 面の延長線以下に配置される、項目 5 0 から 5 2 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 6 8)

前記第 1 接続部及び前記第 2 接続部は、前記第 5 面及び前記第 6 面と離隔して配置される、項目 5 0 から 5 2 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 6 9)

前記第 1 コーナー部及び前記第 2 コーナー部は、前記第 2 面と離隔して配置される、項目 5 0 から 5 2 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 7 0)

前記第 1 めっき層は、前記絶縁層の前記第 1 外部電極上に配置された端を覆うように配置され、前記第 2 めっき層は、前記絶縁層の前記第 2 外部電極上に配置された端を覆うように配置される、項目 5 0 から 5 2 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 7 1)

前記絶縁層は、前記第 1 めっき層の前記第 1 外部電極上に配置された端を覆うように配置され、前記絶縁層は、前記第 2 めっき層の前記第 2 外部電極上に配置された端を覆うように配置される、項目 5 0 から 5 2 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 7 2)

前記絶縁層は、前記第 5 面及び前記第 6 面の一部を覆うように配置される、項目 5 0 から 5 2 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 7 3)

前記絶縁層は、前記第 5 面及び前記第 6 面の全部を覆うように配置される、項目 5 0 から 5 2 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 7 4)

前記第 3 面の延長線から前記第 1 バンド部の端までの前記第 2 方向の平均サイズを B 1、前記第 4 面の延長線から前記第 2 バンド部の端までの前記第 2 方向の平均サイズを B 2 とするとき、

B 1 G 1 及び B 2 G 2 を満たす、項目 5 0 から 5 2 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 7 5)

誘電体層及び前記誘電体層を間に挟んで交互に配置される第 1 内部電極及び第 2 内部電極を含み、第 1 方向に対向する第 1 面及び第 2 面、前記第 1 面及び前記第 2 面と連結され、第 2 方向に対向する第 3 面及び第 4 面、前記第 1 面から前記第 4 面と連結され、第 3 方向に対向する第 5 面及び第 6 面を含む本体と、前記第 3 面に配置される第 1 連結電極及び前記第 1 面に配置されて前記第 1 連結電極と連結される第 1 バンド電極を含む第 1 外部電極と、前記第 4 面に配置される第 2 連結電極及び前記第 1 面に配置されて前記第 2 連結電極と連結される第 2 バンド電極を含む第 2 外部電極と、

前記第 2 面上に配置され、前記第 1 連結電極及び前記第 2 連結電極上に延長して配置される絶縁層と、

前記第 1 バンド電極上に配置される第 1 めっき層と、前記第 2 バンド電極上に配置される第 2 めっき層と、を含み、

前記絶縁層はガラスを含み、前記絶縁層のうち前記第 2 面上に配置された領域は前記第 1 方向に凸形状を有する、積層型電子部品。

(項目 7 6)

前記絶縁層のうち前記第 2 面上に配置された領域は、前記第 2 方向の中央における前記第 1 方向のサイズが前記第 2 方向の端部における前記第 1 方向のサイズより大きい、項目 7 5 に記載の積層型電子部品。

(項目 7 7)

前記絶縁層のうち前記第 2 面上に配置された領域は、前記第 3 方向の中央における前記

10

20

30

40

50

第 1 方向のサイズが前記第 3 方向の端部における前記第 1 方向のサイズより大きい、項目 7 6 に記載の積層型電子部品。

(項目 7 8)

前記第 1 内部電極は前記第 3 面と連結され、前記第 4 面と離隔して配置され、前記第 2 内部電極は前記第 4 面と連結され、前記第 3 面と離隔して配置され、

前記第 3 面と前記第 2 内部電極が離隔した領域の前記第 2 方向の平均サイズを  $G_1$ 、前記第 4 面と前記第 1 内部電極が離隔した領域の前記第 2 方向の平均サイズを  $G_2$ 、

前記第 1 面のうち前記第 3 面の延長線から  $G_1$  だけ離隔した地点から前記絶縁層の外表面までの前記第 1 方向の平均サイズを  $L_{1a}$ 、前記第 1 面のうち前記第 4 面の延長線から  $G_2$  だけ離隔した地点から前記絶縁層の外表面までの前記第 1 方向の平均サイズを  $L_{2a}$ 、前記第 1 面の前記第 2 方向の中央から前記絶縁層の外表面までの前記第 1 方向の平均サイズを  $L_c$  とするとき、

$0.4 \leq L_{1a} / L_c \leq 0.8$  及び  $0.4 \leq L_{2a} / L_c \leq 0.8$  を満たす、項目 7 5 から 7 7 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 7 9)

前記第 1 面から前記第 1 内部電極及び前記第 2 内部電極のうち前記第 1 面に最も近く配置された内部電極までの前記第 1 方向の平均サイズを  $H_1$ 、前記第 1 面の延長線から前記第 1 連結電極及び前記第 2 連結電極上に配置された前記第 1 めっき層及び前記第 2 めっき層の端までの前記第 1 方向の平均サイズを  $H_2$  とするとき、 $H_1 \leq H_2$  を満たす、項目 7 5 から 7 7 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 8 0)

前記第 1 面から前記第 1 内部電極及び前記第 2 内部電極のうち前記第 1 面に最も近く配置された内部電極までの前記第 1 方向の平均サイズを  $H_1$ 、前記第 1 面の延長線から前記第 1 連結電極及び前記第 2 連結電極上に配置された前記第 1 めっき層及び前記第 2 めっき層の端までの前記第 1 方向の平均サイズを  $H_2$  とするとき、 $H_1 < H_2$  を満たす、項目 7 5 から 7 7 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 8 1)

前記本体の前記第 1 方向の平均サイズを  $T$  とするとき、

前記  $H_2$  及び  $T$  は  $H_2 < T / 2$  を満たす、項目 8 0 に記載の積層型電子部品。

(項目 8 2)

前記第 1 めっき層及び前記第 2 めっき層は、前記第 1 面の延長線未滿に配置される、項目 7 5 から 7 7 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 8 3)

前記第 1 面上に配置され、前記第 1 バンド電極と前記第 2 バンド電極との間に配置される追加絶縁層をさらに含む、項目 7 5 から 7 7 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 8 4)

前記第 1 連結電極及び前記第 2 連結電極は、 $Ni$  及び  $Ni$  合金のうち一つ以上を含む、項目 7 5 から 7 7 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 8 5)

前記積層型電子部品の前記第 2 方向の最大サイズは  $1.1\text{ mm}$  以下であり、前記第 3 方向の最大サイズは  $0.55\text{ mm}$  以下である、項目 7 5 から 7 7 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 8 6)

前記誘電体層の平均厚さは  $0.35\text{ }\mu\text{m}$  以下である、項目 7 5 から 7 7 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 8 7)

前記第 1 内部電極及び前記第 2 内部電極の平均厚さは  $0.35\text{ }\mu\text{m}$  以下である、項目 7 5 から 7 7 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 8 8)

前記誘電体層を間に挟んで交互に配置される前記第 1 内部電極及び前記第 2 内部電極を

10

20

30

40

50

含む容量形成部、及び前記容量形成部の前記第 1 方向の両端面上に配置されるカバー部を含み、

前記カバー部の前記第 1 方向の平均サイズは  $15\ \mu\text{m}$  以下である、項目 75 から 77 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 89)

前記第 1 めっき層及び前記第 2 めっき層の平均厚さは、前記絶縁層のうち前記第 1 連結電極及び前記第 2 連結電極上に配置された領域の平均厚さより薄い、項目 75 から 77 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 90)

前記第 1 連結電極及び前記第 2 連結電極は、前記第 5 面及び前記第 6 面と離隔して配置される、項目 75 から 77 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 91)

前記第 1 連結電極及び前記第 2 連結電極は、前記第 2 面と離隔して配置される、項目 75 から 77 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 92)

前記第 1 めっき層は、前記絶縁層の前記第 1 外部電極上に配置された端を覆うように配置され、前記第 2 めっき層は、前記絶縁層の前記第 2 外部電極上に配置された端を覆うように配置される、項目 75 から 77 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 93)

前記絶縁層は、前記第 1 めっき層の前記第 1 外部電極上に配置された端を覆うように配置され、前記絶縁層は、前記第 2 めっき層の前記第 2 外部電極上に配置された端を覆うように配置される、項目 75 から 77 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 94)

前記絶縁層は、前記第 5 面及び前記第 6 面に延長されて前記第 5 面及び前記第 6 面の一部を覆うように配置される、項目 75 から 77 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 95)

前記絶縁層は、前記第 5 面及び前記第 6 面に延長されて前記第 5 面及び前記第 6 面の全部を覆うように配置される、項目 75 から 77 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 96)

前記絶縁層は、前記第 2 面を全部覆うように配置される、項目 75 から 77 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 97)

前記本体は、前記第 1 面と前記第 3 面を連結する第 1 - 3 コーナー、前記第 1 面と前記第 4 面を連結する第 1 - 4 コーナー、前記第 2 面と前記第 3 面を連結する第 2 - 3 コーナー、前記第 2 面と前記第 4 面を連結する第 2 - 4 コーナーを含み、

前記第 1 - 3 コーナー及び前記第 2 - 3 コーナーは、前記第 3 面に近づくほど、前記本体の前記第 1 方向の中央に収縮した形態を有し、前記第 1 - 4 コーナー及び前記第 2 - 4 コーナーは、前記第 4 面に近づくほど、前記本体の前記第 1 方向の中央に収縮した形態を有し、

前記第 1 連結電極は、前記第 1 - 3 コーナー及び前記第 2 - 3 コーナー上に延長して配置されるコーナー部を含み、前記第 2 連結電極は、前記第 1 - 4 コーナー及び前記第 2 - 4 コーナー上に延長して配置されるコーナー部を含む、項目 75 から 77 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 98)

前記第 1 外部電極は、前記第 2 面に配置されて前記第 1 連結電極と連結される第 3 バンド電極をさらに含み、

前記第 2 外部電極は、前記第 2 面に配置されて前記第 2 連結電極と連結される第 4 バンド電極をさらに含む、項目 75 から 77 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 99)

前記第 3 面の延長線から前記第 1 バンド電極の端までの距離を  $B_1$ 、前記第 4 面の延長

10

20

30

40

50

線から前記第 2 バンド電極の端までの距離を B 2、前記第 3 面の延長線から前記第 3 バンド電極の端までの距離を B 3、前記第 4 面の延長線から前記第 4 バンド電極の端までの距離を B 4、前記第 3 面と前記第 2 内部電極が離隔した領域の前記第 2 方向の平均サイズを G 1、前記第 4 面と前記第 1 内部電極が離隔した領域の前記第 2 方向の平均サイズを G 2 とするとき、

B 1 G 1、B 3 G 1、B 2 G 2 及び B 4 G 2 を満たす、項目 9 8 に記載の積層型電子部品。

( 項目 1 0 0 )

前記第 3 面の延長線から前記第 1 バンド電極の端までの距離を B 1、前記第 4 面の延長線から前記第 2 バンド電極の端までの距離を B 2、前記第 3 面の延長線から前記第 3 バンド電極の端までの距離を B 3、前記第 4 面の延長線から前記第 4 バンド電極の端までの距離を B 4、前記第 3 面と前記第 2 内部電極が離隔した領域の前記第 2 方向の平均サイズを G 1、前記第 4 面と前記第 1 内部電極が離隔した領域の前記第 2 方向の平均サイズを G 2 とするとき、

B 1 G 1、B 3 G 1、B 2 G 2 及び B 4 G 2 を満たす、項目 9 8 に記載の積層型電子部品。

( 項目 1 0 1 )

前記第 1 バンド電極及び前記第 2 バンド電極は、前記内部電極に含まれた金属と同じ金属を含む、項目 7 5 から 7 7 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

( 項目 1 0 2 )

前記第 1 連結電極及び前記第 2 連結電極は、前記内部電極に含まれた金属と同じ金属を含む、項目 7 5 から 7 7 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

( 項目 1 0 3 )

前記第 1 バンド電極及び前記第 2 バンド電極は、導電性金属及びガラスを含む焼成電極である、項目 7 5 から 7 7 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

( 項目 1 0 4 )

前記第 1 連結電極及び前記第 2 連結電極は、導電性金属及びガラスを含む焼成電極である、項目 7 5 から 7 7 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

( 項目 1 0 5 )

前記第 1 バンド電極及び前記第 2 バンド電極はめっき層である、項目 7 5 から 7 7 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

( 項目 1 0 6 )

前記第 1 連結電極及び前記第 2 連結電極はめっき層である、項目 7 5 から 7 7 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

( 項目 1 0 7 )

前記同じ金属は N i である、項目 1 0 1 に記載の積層型電子部品。

( 項目 1 0 8 )

前記同じ金属は N i である、項目 1 0 2 に記載の積層型電子部品。

( 項目 1 0 9 )

前記導電性金属は、ニッケル ( N i )、銅 ( C u ) 及びそれらの合金のうちの一つ以上である、項目 1 0 3 に記載の積層型電子部品。

10

20

30

40